

平成28年度 第2回 ホットスタンピング研究部会

〔次第〕

日時:平成28年10月7日(金)10:00~17:00

会場:機械振興会館 6階 6D-4 (東京都港区芝公園3-5-8)

1. 10:00-11:00「通電加熱による熱間ブロー成形のご紹介」

住友重機械工業(株) 雑賀 雅之 氏

2. 11:00-12:00 「Tailor Rolled Blank の概要とホットスタンピング部品への採用事例」

ムベア・ジャパン(株) 村元 雅和 氏

12:00-13:00 休憩

3. 13:00-14:50 「通電加熱ホットスタンピング」

横浜国立大学 前野 智美 氏

4. 14:50-15:30 「ホットスタンピングにおけるスプリングバック低減メカニズムと薄鋼板」

豊橋技術科学大学 中川 佑貴 氏

5. 15:30-15:50 今後の活動内容

15:50-16:00 休憩

6. 16:00-17:00 意見交換会